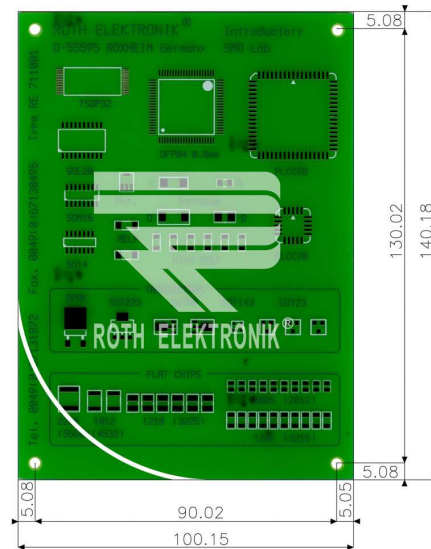
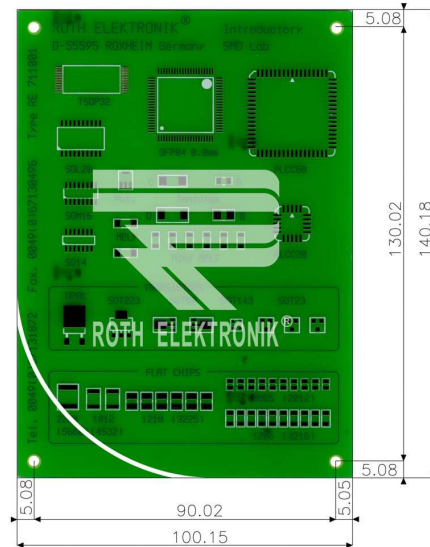




RE711001-LF

- Epoxy fibre-glass FR4 1.50 mm
- Single-sided 35 µm Cu
- Without holes
- Hot air leveling (HAL-leadfree) with solder stop mask
- Component print
- PCB for 57 solder practices for implementation into the SMD surface mounted device: PLCC 20, 68
 - QFP 84 sq.
 - TSOP32 1 x
 - SO14 1 x
 - SOM16 1 x
 - SOL20 1 x
 - SOT23 3 x
 - SOT143 1 x
 - SOT89 2 x
 - SOT233 1 x
 - DPAK 1 x
 - Poti. 1 x
 - Tantal Chip Kond. A 1 x
 - Tantal Chip Kond. B 1 x
 - Tantal Chip Kond. C 1 x
 - Tantal Chip Kond. D 1 x
 - 1206 Chip Kond. 10 x
 - 0805 Chip Kond. 10 x
 - 1210 Chip Kond. 6 x
 - 1812 Chip Kond. 2 x
 - 2220 Chip Kond. 1 x
 - 2308 Melf 2 x
 - 1206 Mini Melf 6 x
- Suitable for Pick & Place
- Size 100 x 140 mm

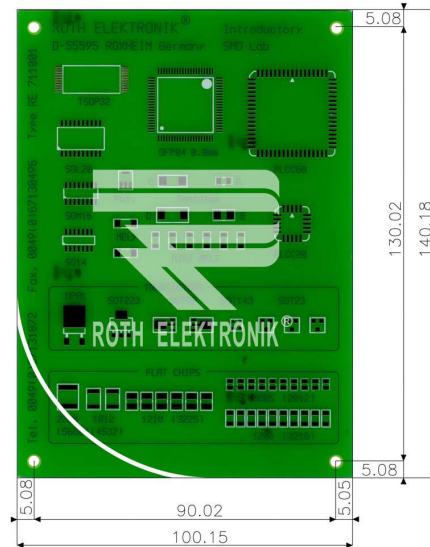
ver.20150130



RE711001-LF

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Ohne Bohrungen
- Heißverzinnt (HAL-leadfree) mit Lötstopplack beschichtet
- Bestückungsdruck
- Platine mit 57 Lötübungen zur Einführung in die SMD Oberflächenmontage: PLCC 20, 68
QFP 84 sq.
TSOP32 1 x
SO14 1 x
SOM16 1 x
SOL20 1 x
SOT23 3 x
SOT143 1 x
SOT89 2 x
SOT233 1 x
DPAK 1 x
Poti. 1 x
Tantal Chip Kond. A 1 x
Tantal Chip Kond. B 1 x
Tantal Chip Kond. C 1 x
Tantal Chip Kond. D 1 x
1206 Chip Kond. 10 x
0805 Chip Kond. 10 x
1210 Chip Kond. 6 x
1812 Chip Kond. 2 x
2220 Chip Kond. 1 x
2308 Melf 2 x
1206 Mini Melf 6 x
- Auch für Maschinenbestückung geeignet (Pick & Place)
- Größe 100 x 140 mm

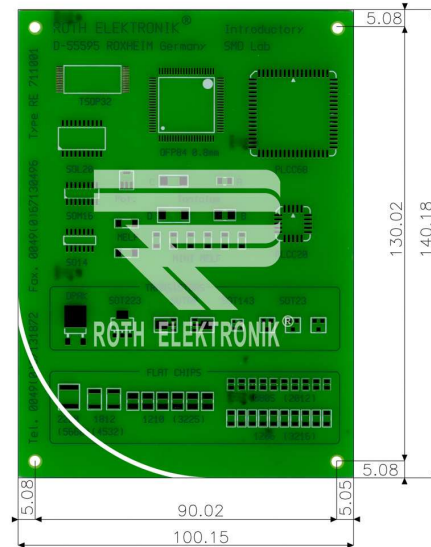
ver.20150130



RE711001-LF

- Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm
- Simple face 35 µm Cu
- Sans trous
- Étamée à chaud (HAL-leadfree) et un laque d'arrêt de soudure
- Impression d'insertion
- Cartes pour l'introduction au montage de surface CMS 57 différents PLCC 20, 68
 - QFP 84 sq.
 - TSOP32 1 x
 - SO14 1 x
 - SOM16 1 x
 - SOL20 1 x
 - SOT23 3 x
 - SOT143 1 x
 - SOT89 2 x
 - SOT233 1 x
 - DPAK 1 x
 - Poti. 1 x
 - Tantal Chip Kond. A 1 x
 - Tantal Chip Kond. B 1 x
 - Tantal Chip Kond. C 1 x
 - Tantal Chip Kond. D 1 x
 - 1206 Chip Kond. 10 x
 - 0805 Chip Kond. 10 x
 - 1210 Chip Kond. 6 x
 - 1812 Chip Kond. 2 x
 - 2220 Chip Kond. 1 x
 - 2308 Melf 2 x
 - 1206 Mini Melf 6 x
- Egalement adaptée à l'insertion automatique (Pick & Place)
- Dimensions 100 x 140 mm

ver.20150130



RE711001-LF

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Sin perforación
- Estañado en caliente (HAL-leadfree) y evestido de laca inhibidora de soldadura
- Impresión de posición por el lado de los componentes
- Placa de circuito impreso con 57 componentes SMD para la introducción en el montaje de superficie SMD: PLCC 20, 68
QFP 84 sq.
TSOP32 1 x
SO14 1 x
SOM16 1 x
SOL20 1 x
SOT23 3 x
SOT143 1 x
SOT89 2 x
SOT233 1 x
DPAK 1 x
Poti. 1 x
Tantal Chip Kond. A 1 x
Tantal Chip Kond. B 1 x
Tantal Chip Kond. C 1 x
Tantal Chip Kond. D 1 x
1206 Chip Kond. 10 x
0805 Chip Kond. 10 x
1210 Chip Kond. 6 x
1812 Chip Kond. 2 x
2220 Chip Kond. 1 x
2308 Melf 2 x
1206 Mini Melf 6 x
- Adecuada también para la dotación automática (Pick & Place)
- Tamaño: 100 x 140 mm

ver.20150130